

Plaskon SMT-B-1LAS

Епоху; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound optimized specifically for grid arrays (BGA/LGA) requiring low alpha particle count. It has the same unique resin system as the SMT-B-1, which minimizes warpage and enables trouble-free molding onto rigid and flexible laminate substrates. An all-spherical filler system ensures outstanding moldability both with automated and conventional molding systems. Minimal dimensional change after molding, post bake and subsequent solder treatment make this compound an excellent choice for grid array applications.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Хорошая стабильность размеров Низкий уровень защиты Низкая вязкость Высокотемпературная прочность Ускоренная Настройка		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.88	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.050	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
21°C	1.37	MPa	ASTM D790
215°C	0.588	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
21°C	0.0108	MPa	ASTM D790
215°C	0.00441	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	220	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.6E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.70	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	16	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	3.70		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	2.1E-3		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	34	%	ASTM D2863

Дополнительная информация

Recommended Storage Temperature: <5°C
Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months
Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 5 days
Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days
Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 140 cm
Automatic Orifice Viscosity, 175°C, Shear Rate is 100000 sec⁻¹, 1 mm die length, 1/2 mm diameter: 45 poise
Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 15 sec
Ash Content: 77 %
Hydrolyzable Halides: <1 ppm
Alpha Particle Count: <0.001 counts/cm²/hr
Cull Hot Hardness, Shore D, 90 sec, 175°C: 75
Volume Resistivity, 22°C: 1e15 ohm-cm
All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 16 cm⁻⁶/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 68 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Preheat Temperature: 90 to 100°C

Molding Temperature: 170 to 185°C

Molding Pressure: 750 to 1000 psi

Cure Time, 177°C: 2 to 3min

Post Mold Cure Time, 175°C: 4 to 5 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

